

BPI-2000

UV 光固化改性聚酰亚胺树脂

INTRODUCTION

应用：BPI-2000 是加聚型聚酰亚胺（PI）树脂，其分子结构中引入高活性的 C=C 双键，因受相邻两个强吸电子羰基的影响而高度缺电子，在加热或催化剂作用下可发生交联固化，形成具有高交联密度和刚性环状结构（苯环、酰亚胺环）的高分子材料。这一独特的结构赋予其卓越的综合性能：其分解温度超过 420℃，长期使用温度范围达 177-232℃，兼具高强度、高模量、低热膨胀系数、高导热性、优异的耐湿热、耐辐射、阻燃以及耐各类溶剂和酸碱的特性。

TYPICAL VALUES

外观	淡黄色粉末
分子量 (GPC)	35000
熔点℃	160-170
介电常数 (1kHz)	3.85
纯度%	99.5
酸值 mg KOH/g	max. 1

APPLICATION

电子信息：凭借其低介电常数和低介电损耗，它被广泛用作制造高频高速覆铜板的基底树脂，是印刷电路板（PCB）实现高速、高保真信号传输的核心材料，对于人工智能服务器、计算机、自动驾驶及智能医疗设备等尖端电子产品的小型化与高性能化至关重要。

防护与粘接：在安全防护领域由它制备的阻燃防护服在接触火焰时能迅速炭化形成隔离层，有效阻止燃烧并防止熔融滴落，以其为主体的特种胶粘剂可在 260℃ 下长期使用，广泛应用于航空航天领域，用于钛合金、铝合金及陶瓷等材料的结构粘接。

磨具成型：树脂具有自润滑特性、摩擦系数低、耐磨性强，同时保持优异的弯曲和冲击强度。

INTERMISCIBILITY

单体：与 VM-3540 AM-317 等单体相溶性好。

溶剂：推荐使用 NMP 等极性溶剂，或者加热溶于苯类或者酮类溶剂。

packing: 25kg 每桶

更详尽的应用参考资料及 MSDS 备案……